

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或建議。

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公佈全部或部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈(董事共同及個別對其負上全責)所載資料乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重要方面確屬準確及完整，且不含誤導成份；(2)本公佈並無遺漏其他事實，以致其內任何聲明產生誤導；及(3)本公佈所表達意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並基於公平合理之基準及假設。

**INTCERA**  
**INTCERA HIGH TECH GROUP LIMITED**  
**大陶精密科技集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

[www.intcera.com](http://www.intcera.com)

**私人配售股份**

**本公司配售代理**



**第一證券(香港)有限公司**

於二零零三年二月二十日，本公司與配售代理訂立配售協議，本公司同意委任配售代理，而配售代理同意接納上述委任，盡力按配售價配售本公司之配售股份。

配售協議須待(a)聯交所創業板上市委員會批准配售股份上市買賣；(b)本公司取得有關當局之一切同意與批准(如適用)；(c)配售代理之責任成為無條件，且並無根據配售協議之條款(包括有關不可抗力事件之規定)終止及達成其他條件後，方可完成。

經扣除有關開支後，配售所得款項淨額估計約為16,400,000港元，其中約(i)10,000,000港元將用作研究及開發光纖零件之生產技術；(ii)4,000,000港元將用作償還銀行貸款；及(iii)2,400,000港元則作為本公司之一般營運資金。

由於配售股份之總面值超逾本公司已發行股本15%，故此根據創業板上市規則第19.06條，該交易屬一項須予披露交易。本公司將於本公佈日期後21日內向股東寄發通函。

## 於二零零三年一月二十日訂立之配售協議

### 發行者

本公司

### 配售代理

配售代理為獨立第三者，與本公司或其附屬公司之董事、主要行政人員、主要股東及彼等各自之聯繫人士(定義見創業板上市規則)概無關連。

### 將配售之股份數目

配售代理將配售120,500,000股新股份。

配售股份相等於(1)本公佈日期本公司全部已發行股本約19.99%；及(2)經發行配售股份而擴大之本公司已發行股本約16.67%。

當繳足股款後，配售股份將在各方面與現已發行股份享有同等權利，包括可收取於完成配售當日後可能宣派、作出或派付之一切股息及分派。

### 一般授權

配售股份將根據董事於二零零二年七月十七日舉行之本公司股東特別大會上獲授之一般授權而發行。

### 承配人

配售代理承諾盡力將配售股份配售予與本公司或其附屬公司任何董事、主要行政人員、主要股東、管理層股東及彼等各自聯繫人士(定義見創業板上市規則)概無關連之獨立機構及／或專業投資者。

### 配售價

配售價為每股0.140港元，較股份於二零零三年二月十九日(即股份於刊發本公佈前在聯交所之最後交易日)在聯交所之收市價每股0.167港元折讓約16.2%，而較股份於截至及包括二零零三年二月十九日止最後十個交易日在聯交所之平均收市價每股0.1624港元折讓約13.8%。董事在考慮配售前當時之市況後，認為配售之條款公平合理，且符合本公司股東之整體利益。

配售價由本公司與配售代理經公平磋商而釐定。董事認為，配售之條款公平合理，而配售符合本公司及其股東之整體利益。

### **配售協議之條件**

配售協議須待(a)聯交所創業板上市委員會於二零零三年三月十三日或配售代理與本公司協定之其他日期前批准配售股份上市買賣；(b)本公司取得有關當局之一切同意與批准(如適用)；(c)配售代理之責任成為無條件，且並無根據配售協議之條款(包括有關不可抗力事件之規定)終止及達成其他條件後，方可完成。

### **申請上市**

本公司將向聯交所創業板上市委員會申請，批准或同意批准配售股份上市買賣。

### **完成**

截至本公佈日期，並無任何股份配售予承配人。預期配售協議將於二零零三年三月十三日或本公司與配售代理協定之較後日期或之前達成配售條件後一個營業日完成。本公司將於配售完成時另行發出有關配售結果之公佈。

### **配售之理由及所得款項用途**

本公司主要從事製造及銷售陶瓷素材及套圈。為應付本公司擴展業務所需及提供一般營運資金，董事認為以配售新股方式擴大本公司資本基礎對本公司及其股東有利。經扣除有關開支後，配售所得款項淨額估計約為16,400,000港元，有關用途如下：

- a) 約10,000,000港元將用作研究及開發光纖零件之生產技術；
- b) 約4,000,000港元將用作償還銀行貸款；及
- c) 約2,400,000港元則作為本公司之一般營運資金。

## 控權股東所擁有之本公司權益

### 股權架構

以下為完成配售前後本公司之股權架構：

股東名稱	配售前之持股量		配售後之持股量	
	股份數目	百分比	股份數目	百分比
太平	156,017,435	25.89%	156,017,435	21.58%
董大勇	33,637,500	5.58%	33,637,500	4.65%

由於配售股份之總面值超逾本公司已發行股本15%，故此根據創業板上市規則第19.06條，該交易屬一項須予披露交易。本公司將於本公佈日期後21日內向股東寄發通函。

### 釋義

「營業日」	指	香港銀行之營業日（星期六及星期日除外）
「本公司」	指	大陶精密科技集團有限公司，於開曼群島註冊成立之受豁免有限公司，其股份在聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「創業板上市規則」	指	聯交所創業板證券上市規則
「配售」	指	私人配售配售股份
「配售代理」	指	第一證券(香港)有限公司，根據香港法例第333章證券條例註冊之證券交易商
「配售協議」	指	本公司與配售代理於二零零三年二月二十日就按配售價配售配售股份而訂立之有條件配售協議
「配售價」	指	每股本公司股份0.140港元
「配售股份」	指	本公司將配售合共120,500,000股之新普通股
「股份」	指	本公司每股面值0.01港元之普通股

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司創業板
「太平」	指	太平企業股份有限公司，於台灣註冊成立之公司，由本公司行政總裁兼執行董事董大勇先生及其家族成員分別持有28.8%及45.9%，於本公佈日期擁有156,017,435股股份，相等於本公司已發行股本約25.89%
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比

承董事會命  
**大陶精密科技集團有限公司**  
 行政總裁  
**董大勇**

香港，二零零三年二月二十日

\* 僅供識別

本公佈將由刊登日期後在創業板網站「最新公司公告」刊登至少七日。